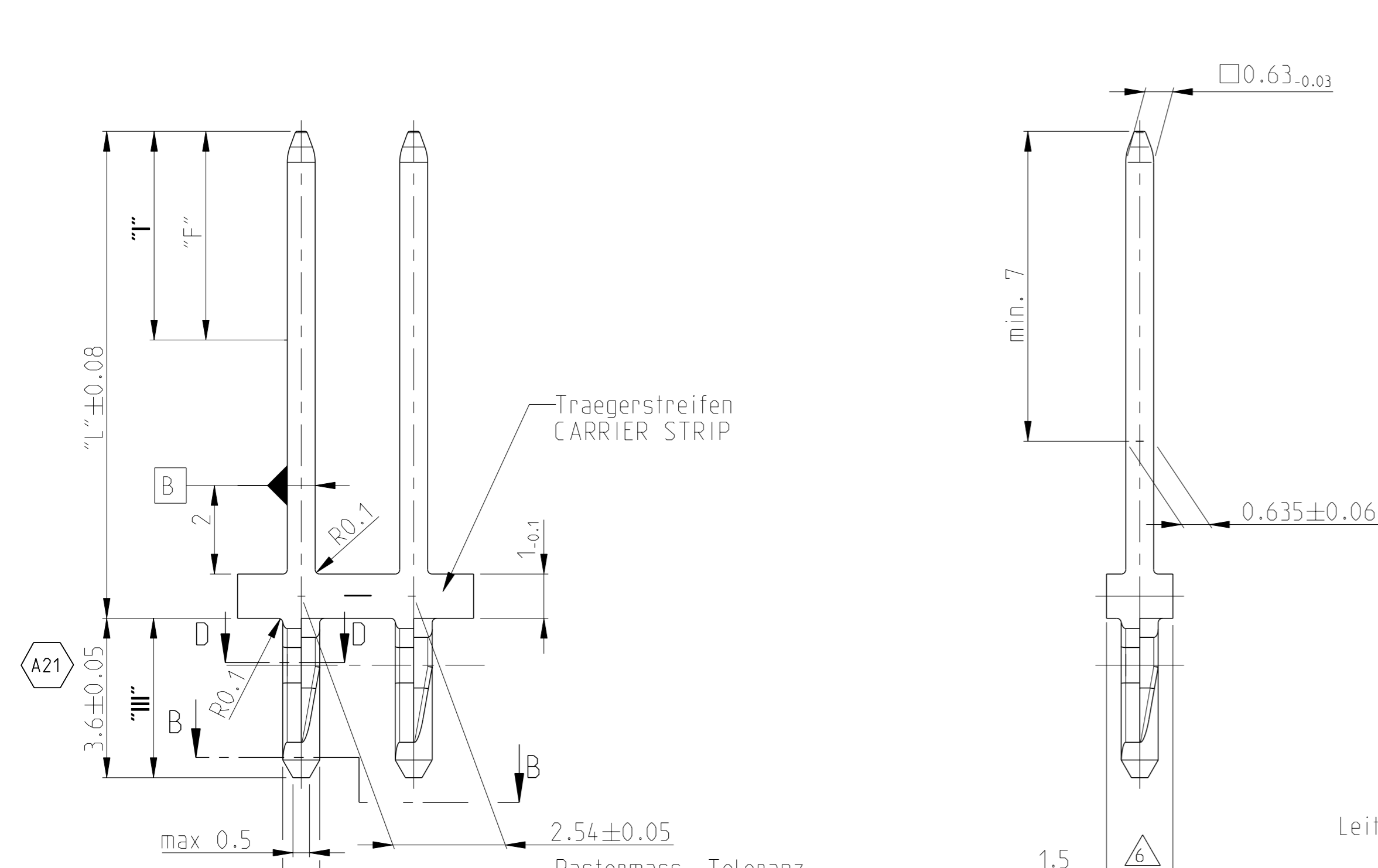
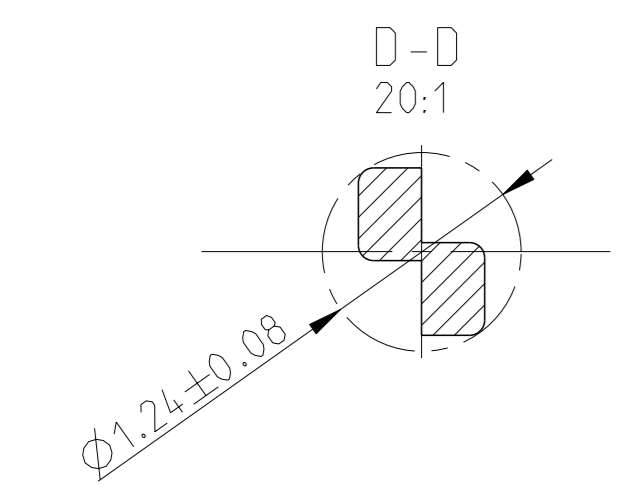
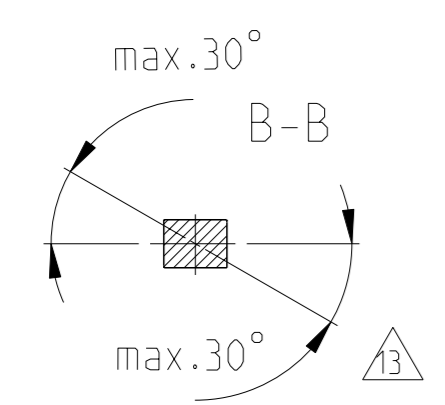


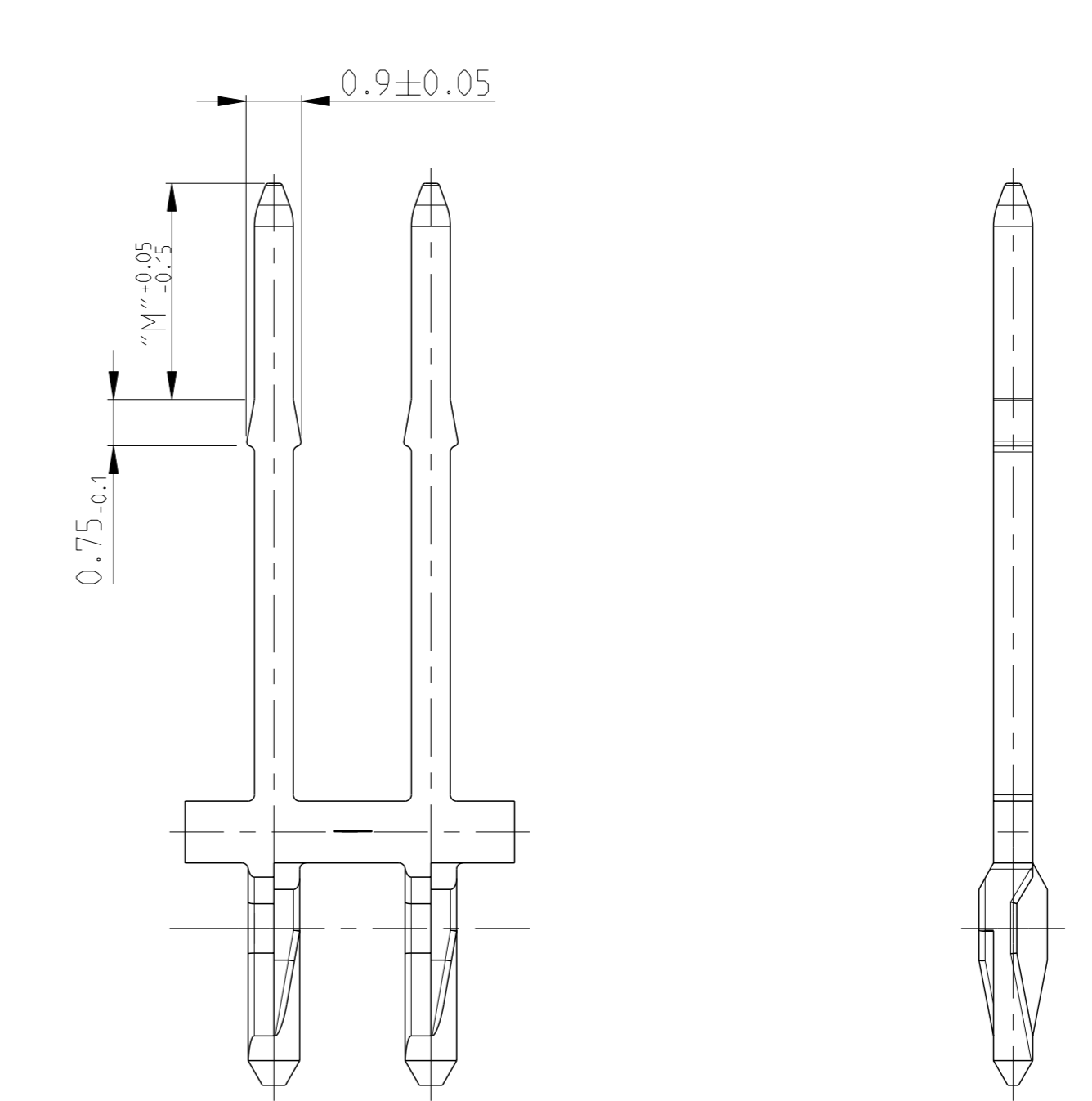
# VERSION A



Rastermass, Toleranz pro 30 Kontakte ±0.2  
PITCH DIMENSION, TOLERANCES PER 30 CONTACTS ±0.2



# VERSION B

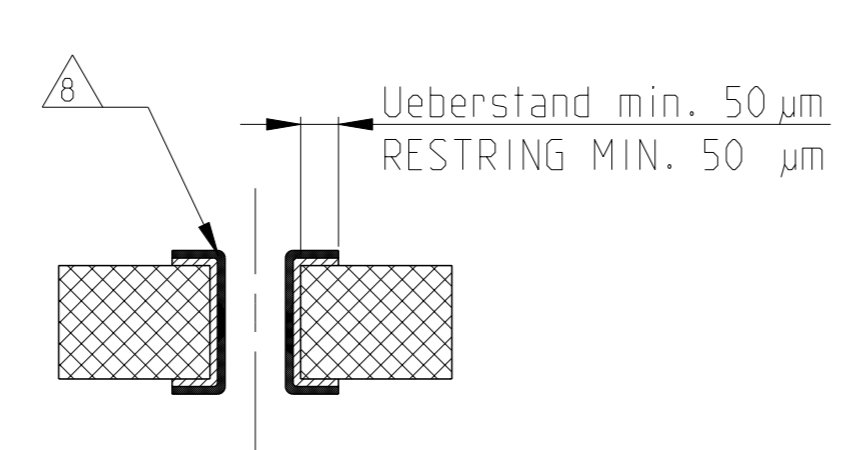


### Bemerkungen NOTES

- 1 Massgebend ist der deutsche Text  
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- 2 Verwendung fuer Leiterplattendicke: 1.6 ± 0.14mm  
USED ON PCB THICKNESS: 1.6 ± 0.14mm
- 3 :
- 4 Loetbarkeit nach DIN 40046  
SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN 40046
- 5 Kontaktstift siehe Zeichnung, TE 114-94201, Version B  
CONTACT PIN SEE DRAWING TE 114-94201, VERSION B
- 6 Zustand vor dem Einpressen  
STATUS BEFORE INSERTION
- 7 Zulaessige Saebelfoermigkeit: 40mm/m  
PERMITTED SABERSHARPNESS: 40mm/m
- 8 Einpresszone fuer 1.6mm Leiterplatte  
Anforderung an Leiterplattenloch, siehe Tabelle  
PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB  
REQUIREMENTS ON PCB HOLE, SEE TABLE
- 9 Verpackungseinheit: 50.000 Stck. auf Einweg Kunststoff-Spule Ø 588mm  
mit Zwischenlagenpapier, 3 Spulen im Karton  
PACKAGING UNIT: 50.000 PCS ON ONE-WAY PLASTIC REEL DIA. 588MM  
WITH INTERLEAVING PAPER, 3 REELS IN BOX.
- 10 Lochaufbau (Zinn/Blei) in der Leiterplatte (siehe Tabelle)  
HOLE CONSTRUCT (TIN/LEAD) FOR PCB (SEE TABLE)
- 11 Lochaufbau (Nickel/Gold) in der Leiterplatte (siehe Tabelle)  
HOLE CONSTRUCT (NICKEL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE)
- 12 Lochaufbau (Zinn) in der Leiterplatte (siehe Tabelle)  
HOLE CONSTRUCT (TIN) FOR PCB (SEE TABLE)
- 13 Verdrehung Action Pin Spitze max. 30 °  
DISTORTION OF ACTION PIN TIP MAX. 30 DEG.
- 14 Material spezifiziert nach UNS C19002  
MATERIAL SPECIFIED ACCORDING TO UNS C19002

1:1

### Lochaufbau in der Leiterplatte HOLE CONSTRUCT FOR PCB



### Durchplattierte Bohrung, Spezifikation PLATING ACROSS OF HOLE, SPEC.

Lochaufbau LP HOLE CONSTRUCT PCB	△10	△11	△12
Kupferschicht COPPER COATING	25-75 µm	25-75 µm	25-50 µm
Zinn/Blei Schicht TIN/LEAD COATING	4-10 µm	-	-
Zinn Schicht TIN COATING	-	-	0.5-1.5 µm
Nickel Schicht NICKEL COATING	-	max. 5 µm	-
Gold Schicht GOLD COATING	-	max. 0.2 µm	-
Bohr Ø HOLE DIA.	1.15±0.025	1.15±0.025	1.15±0.025
Plattierter Ø PLATED DIA.	1 +0.09 -0.06	1 +0.09 -0.06	1.07+0.055 -0.045

### Oberflaeche/SURFACE

<b>Zone "I" AREA</b>	Goldausfuehrung: 0.8 µm bis 2 µm Au ueber Ni GOLD VERSION: 0.8 µm TO 2 µm Au OVER Ni Zinn-Ausfuehrung: 1 µm bis 3 µm Sn TIN-VERSION: 1 µm TO 3 µm Sn
<b>Zone "II" AREA</b>	Schichtdicke: 1.3 µm bis 2.2 µm Ni COAT THICKNESS: 1.3 µm TO 2.2 µm Ni
<b>Zone "III" AREA</b>	Schichtdicke: 0.8 µm bis 1.8 µm Sn ueber Ni COAT THICKNESS: 0.8 µm TO 1.8 µm Sn OVER Ni

VERSION	TE CONNECTIVITY BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	MATERIAL	OBERFLAECHE SURFACE AREA "F"	PCB HOLE SPEC. LP Bohrungs Spez.	GRAMM GEWICHT WEIGHT	"F"	"L"	"M"	"N"
A	7-963964-9	A	CuNiSi R580S	Zinn/TIN	0.05		7	21.3	-	24.9
	6-963964-5	A		Zinn/TIN			7	11.4	-	15
	2-963964-8	A		Zinn/TIN			7	9.2	-	12.8
3-963964-7	A	Gold/GOLD		5.5			11.1	-	14.7	
2-963964-7	A	Zinn/TIN		7			11.1	-	14.7	
B	2-963964-6	B		Zinn/TIN			7	13.6	7.75	17.2
	2-963964-5	C		Zinn/TIN			8.2	17.8	9.25	21.4
	9-963964-4	A		Zinn/TIN			7	13.6	7.75	17.2
A	8-963964-4	B		Zinn/TIN			7	9.8	-	13.4
	3-963964-4	A		Gold/GOLD			5.5	9.8	-	13.4
	2-963964-4	B		Zinn/TIN			7	9.8	-	13.4
	1-963964-4	B		Gold/GOLD			5.5	9.8	-	13.4
	2-963964-3	B		Zinn/TIN			7	8.05	-	11.65
	1-963964-3	B		Gold/GOLD			5.5	8.05	-	11.65

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. OWN: C. Beu 02DEC2002. CHK: T. Sieler 10DEC2002. NAME: MGS. ACTION PIN FOR 1mm HOLE. ACTION PIN fuer 1mm Loch, freistehend. SIZE: A1. CASE CODE: 00779. DRAWING NO.: 108-18643. PRODUCT SPEC: 108-18643. APPLICATION SPEC: VERARBEITUNGSSPEZ. MATERIAL: -. WEIGHT: -. CUSTOMER DRAWING. SCALE: 10:1. SHEET: 1 OF 1. REV: A21.